

# شرح مميزات الرايم الجديد DDR3 بالتفصيل و الصور

قبل كل شيء السلام عليك ورحمة الله

صلوا على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم

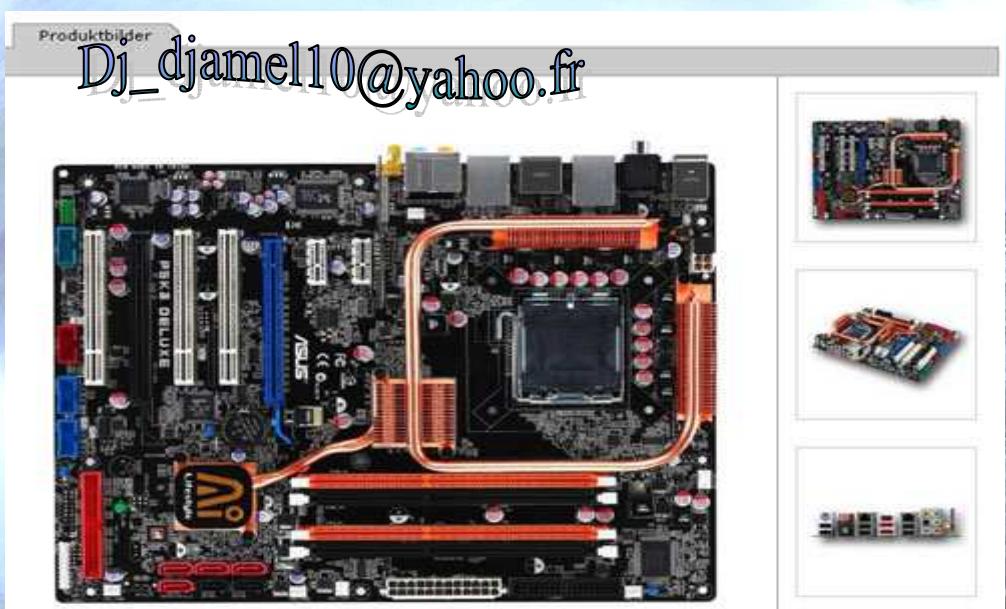
Dj\_djamel10@yahoo.fr





خنوي الذاكرة (DDR3) على الكثير من المزايا التقنية وذلك بالمقارنة بوحدات الذاكرة السابقة. وبالنسبة لعامل اسلاك الكمبيوتر، فقد تقلص ليصل إلى 1.5 فولت فقط فيما ارتفعت السرعة بشكل ملحوظ حيث تتراوح السرعة الحالية لوحدات (DDR3) من 800 ميجاهرتز وحتى 1600 ميجاهرتز. ومن الجدير بالذكر أن وحدة الذاكرة التي تبلغ سعها 512 ميجابايت والتي عُرضت مؤخرًا على الموقع الإلكتروني لشركة (Super Talent) تعتمد على وحدات سامسونج التي لم يتم الإعلان عنها بعد. ومن الناحية المادية فإن الذاكرة (DDR3) تشبه كثيراً الذاكرة (DDR2) فكلا الثنستان تعتمدان على نظام (Fine-pitch Ball Grid Array) لجمع الرقاقة. كما أن الشاشة يشمل النصيم (Pin) 240 - حيث أن كل ناهماً خنوي على نحو 240 طرف توصيل. ويدرك الاختلاف بينهما من السن الأوسط الذي يقع في أماكن مختلفة في كلا الرقاقيين. وعلى الرغم من أن مجموعة (JEDEC) ما زالت في حاجة للانتهاء من المواصفات الخاصة بالرقاقة إلا أن التوقعات تشير إلى طرح تلك الرقاقة في منتصف العام الحالي. وتعمل سوين

## بعض صور اللوحات الامر التي تدعم هذه الامات





بعض التفصيل عن هذه الامات

-1- نطاق تردد اعلى نتائجه زاده سع ساعه

-2- خفض اسفل اسفل الطاقة الكهربائيه نتائجه لطراز تكنولوجيا الصن

-3- ان الجهد ddr3 قد خفض من 1.8v الى 1.5v مما يقلل من كمية الحرارة الناجم

## الفرق بين الرامات DDR3 و DDR2

### DDR3 Key Improvement

		DDR2	DDR3	Remark
Data rate/pin		400 ~ 800	800 ~ 1600	Mbps
Vdd/Vddq		1.8V +/- 0.1 V	1.5V +/- 0.075 V	Low Power
DQ	ODT	Read Other term.	Other term.	
	Write	Other term.	Other term. + Self	
	Shielding on PKG	Limited	All DQ signals	
C/A	Termination	No	Yes	
	Topology	Conventional	Fly-by	
	Driver Control	OCD	Self Cal. with ZQ	
	Leveling	No	Yes	

Intel Developer  
**FORUM**

SAMSUNG

### الفرق بين الرامات DDR2 ..... DDR3..... DDR1

#### DDR3 Feature Comparison

	DDR	DDR2	DDR3 <sup>*1</sup>
Data Rate	200 ~ 400 Mbps	400 ~ 800 Mbps	800 ~ 1600 Mbps <sup>*2</sup>
System Assumption	4slots(8loads)	2slot(4loads)	2slot(4loads) <sup>*2</sup>
Vdd/Vddq	2.5V ± 0.2V	1.8V ± 0.1V	1.5V ± 0.075V
Interface	SSTL_2	SSTL_18	SSTL_15
Package	66TSOP2 60 BGA	60 BGA for x4/x8 84 BGA for x16	78 BGA for x4/x8 96 BGA for x16
Source sync.	Bi-directional DQS (Single ended Default)	Bi-directional DQS (Single./Diff. Option)	Bi-directional DQS (Differential Default)
Burst Length	BL=2,4,8 (2bits Prefetch)	BL = 4, 8 (4bits Prefetch)	BL = 4, 8 (8bits Prefetch)
# of bank	4banks	512Mb : 4banks 1Gb : 8banks	512Mb/1Gb: 8 banks 2Gb/4Gb/8Gb: tbd
CL/tRCD/tRP	~15/15/15ns	~ 15/15/15 ns	~ 12/12/12 ns
Reset	No	No	Yes
ODT	No	Yes	Yes
Driver Calibration	No	Off-Chip Driver Calibration	Self calibration with ZQ Pin
Leveling	No	No	Yes

Note 1: DDR3 Key Features have been fixed in JEDEC.

Note 2: Max. Frequency by DDR3 System Assumption is under discussion.

DDR3 supports 1600Mbps under 1slot/channel system.

And, the Possibility of DDR3 2-Slot/channel system being discussed in JEDEC.



مزيد من المعلومات حول هذه الراوتر

### Sticks/Modules

Module name	Bus clock	Chip type	Peak transfer rate
PC3-6400	400 MHz	DDR3-800	6.40 GB/s
PC3-8500	533 MHz	DDR3-1066	8.53 GB/s
PC3-10600	667 MHz	DDR3-1333	10.67 GB/s [2] 
PC3-12800	800 MHz	DDR3-1600	12.80 GB/s

### Chips

Standard name	Memory clock	I/O Bus clock	Data transfers per second
DDR3-800	100 MHz	400 MHz	800 Million
DDR3-1066	133 MHz	533 MHz	1066 Million
DDR3-1333	166 MHz	667 MHz	1333 Million
DDR3-1600	200 MHz	800 MHz	1600 Million

صلوا على معلمينا و حبيبنا محمد

اللهم صرنا لآخرة صادقة من الناجي